

出展者 (NPI) プレゼンテーション **無料** **事前登録不要** ※一部、要事前登録の可能性がございます。 東1・3・7ホール セミナー会場

東1ホール セミナー会場 4		東3ホール セミナー会場 5		東7ホール セミナー会場 10		東3ホール セミナー会場 6 (クローズ)	
12:15 12:35 13:15	粉体や樹脂表面の濡れ性を改善し、分散性・密着性の向上に繋げるプラズマ親水化技術をご紹介します。 興魁半導体	14:15 14:35	真空印刷機によるVIAへのペースト充填技術 株式会社セリアコーポレーション	10:35 11:15	正確な故障解析へ半導体・電子部品向けマイクロ操作技術 株式会社マイクロサポート	12:55 13:15 13:55	4μm以下の超薄銅箔「MicroThin™」シリーズ及び市場動向のご紹介 三井金属㈱
12:55 13:15	ダイナトロンが提案する部品実装製品のご紹介 ダイナトロン㈱	15:05 15:25 15:55	多様化する半導体パッケージ実装を支える CR-8000 Design Force ㈱図研	11:35 11:55	微細凹凸形成技術で「ガラス表面を機能化」：nanoWave™ 日本電気硝子㈱	13:35 13:55	ガラスへの高密度無電解銅シード形成プロセス 奥野製薬工業㈱
13:25 13:45	AI自動配置 [LayoutX] (仮) ㈱オンテック	15:35 15:55	AIサーバー/半導体パッケージ/5G・6G通信/車載レーダー向け樹脂材料の誘電率評価・銅箔の導電率評価とシミュレーションへの応用 EMラボ㈱	12:45 13:15	次世代AIサーバーを支える高周波銅箔—新製品&技術動向— 三井金属㈱	12:15 12:35	微細配線基板向け次世代AOI技術で歩留まり改善 SCREEN PE ソリューションズ
14:15 14:35	ニコン マスクレス露光装置～次世代AI PKGとフレキシブルデバイス～ ㈱ニコン	11:35 11:55	プラズマ処理を要する! 「マイルドプラズマ」 エステック㈱	13:35 13:55	高感度フレキシブル薄膜バンプみセンサーのご紹介 日本電気硝子㈱	12:55 13:15	AI基板の高速伝送を実現する高精度パッドリソ加工技術 三井金属㈱
10:55 11:15	当社のサマルマナメント製品開発の取り組み タツタ電線㈱	12:15 12:35	AIサーバー/半導体パッケージ/5G・6G通信/車載レーダー向け樹脂材料の誘電率評価・銅箔の導電率評価とシミュレーションへの応用 EMラボ㈱	14:15 14:35	グラビアオフセット印刷を用いた高精度パターンニングプロセスの実現 ㈱セリアコーポレーション	14:15 14:35	AI基板の高速伝送を実現する高精度パッドリソ加工技術 三井金属㈱
11:25 11:45	現場での計画的な人材教育を実現するためのデジタル活用最新情報 Tebiki㈱	12:55 13:15	車載品質で注目された清浄度規格VDA19でも認められたTeknek ローラークリーニングによる「はんだ印刷」異物対策 ㈱ブルックスジャパン	14:45 15:15	インクジェット SR 前処理剤 メックエレクトロニクス メック㈱	14:55 15:15	LTSpiceを電源設計に活用 ㈱三共社
12:55 13:15	フッ素による特異な表面改質技術 高松特産㈱	13:35 13:55	国内Tier1でも採用 クリーン化で品質向上を実現するレーザー基板分割 ㈱ブルックスジャパン	12:55 13:15	熱圧着・ロールプレスの圧力定量化による製品品質・歩留まり向上 富士フィルム㈱	15:35 15:55	LTSpiceを電源設計に活用 ㈱三共社
13:35 13:55	根上工業の強みと製品のご紹介 根上工業㈱	14:15 14:35	電子回路・部品のアルミ化を無洗浄プロセスで実現するはんだ材料 三井金属㈱	13:35 13:55	省人化×少量多品種 時代を制する【新型】自動外観検査機 シライ電子工業㈱	13:35 13:55	電子回路基板用ドリル・ルーターの最新技術情報 ユニオンツール㈱
14:15 14:35	低応力、高速化、非磁性めっき液の開発について 日本化学産業㈱	14:55 15:15	ガラス加工用レーザーシステムの紹介 進谷工業㈱	13:35 13:55	真空印刷機によるVIAへのペースト充填技術 ㈱セリアコーポレーション	13:35 13:55	電子回路基板用ドリル・ルーターの最新技術情報 ユニオンツール㈱
15:35 15:55	世界最高レベルのエリアレーザ技術によるレーザーリフロー (仮) ナラサキ㈱	15:35 15:55	TGVを超えた先端パッケージのためのディフェクトフリー ガラス加工 ㈱ブルックスジャパン	14:15 14:35	AIサーバー/半導体パッケージ/5G・6G通信/車載レーダー向け樹脂材料の誘電率評価・銅箔の導電率評価とシミュレーションへの応用 EMラボ㈱	13:35 13:55	電子回路基板用ドリル・ルーターの最新技術情報 ユニオンツール㈱
12:55 13:15	PI解析を用いた電源ノイズ対策の徹底!! (仮) ㈱オンテック	13:35 13:55	省人化×少量多品種 時代を制する【新型】自動外観検査機 シライ電子工業㈱	12:55 13:15	熱圧着・ロールプレスの圧力定量化による製品品質・歩留まり向上 富士フィルム㈱	13:35 13:55	電子回路基板用ドリル・ルーターの最新技術情報 ユニオンツール㈱
13:35 13:55	パワー半導体から6G基板まで：異素材接着におけるMI活用最新情報 MI-6㈱	14:15 14:35	真空印刷機によるVIAへのペースト充填技術 ㈱セリアコーポレーション	13:35 13:55	省人化×少量多品種 時代を制する【新型】自動外観検査機 シライ電子工業㈱	13:35 13:55	電子回路基板用ドリル・ルーターの最新技術情報 ユニオンツール㈱
14:15 14:35	様々な用途として使用されるセラミック 京セラ㈱	15:35 15:55	AIサーバー/半導体パッケージ/5G・6G通信/車載レーダー向け樹脂材料の誘電率評価・銅箔の導電率評価とシミュレーションへの応用 EMラボ㈱	14:15 14:35	真空印刷機によるVIAへのペースト充填技術 ㈱セリアコーポレーション	13:35 13:55	電子回路基板用ドリル・ルーターの最新技術情報 ユニオンツール㈱

主催者企画：光電融合セミナー・展示 (特別協力：準オプトロニクス社)

無料 **事前登録不要** **東7ホール 特設会場**

専門メディアや有識者によるセミナーや展示等を予定！
 株式会社オプトロニクス社、株式会社総合研究所 等
 ※詳細が決まりましたら展示会公式WEBサイトにてご案内いたします。

他ではゼッタイ聞けない「主催者セミナー」 **無料** **事前登録不要** 東7ホール セミナー会場11

6月10日 (水)		6月12日 (金)	
最先端パッケージング、基板技術		エレクトロニクスの新たな用途を考えるプログラム	
13:00-14:00	初出展!中空構造で超低損失基板を実現 ULTRICIR (株)村田製作所 通信・センサ事業本部 通信モジュール事業部 プリンシパルエンジニア 池本 伸郎	13:00-13:30	【特別講演】アーバン・ワイルドライフとゾーニング管理 加藤 幸子 ㈱AZAYAKA JAPAN 代表取締役 齋藤 学 農学園大学 農食環境学群 環境共生学 野生動物生態学研究室 教授
14:00-15:00	既存PCB工程&フィルム型基板材料を活用したプリント配線板の高周波対応・微細化対応 パソニックインストロム㈱ メタロニクス事業部 ファインエレクトロニクスユニット 事業企画部 企画第二課 課長 森田 剛介	13:30-14:30	エレクトロニクスが変える野生動物の生態調査 (仮) 藤本 靖 NPO法人 南知社・ヒグマ情報センター 主任研究員
15:00-16:00	講演タイトル・調整中 京セラ㈱ ファインセラミックス事業本部 機構部品事業部 機構部品商品技術部 責任者 梅原 幹裕 京セラ㈱ ファインセラミックス事業本部 単結晶事業部 技術部商品技術課 商品技術係 本庄 隆人	14:40-16:00	エレクトロニクスの新たな用途を考える座談会 「異分野融合が拓くアプリケーション」 各講師

スポンサー企業一覧

スポンサー企業一覧

プラチナ: MEIKO, V-TECHNOLOGY

ゴールド: mks, Atotech, ESI, Dynatron, 太陽インキ製造, AKOKI, MUEC

シルバー: KYOSHA, KYOBUN, nikkon, IHARA, TOA MUSENKENI, HIWIN, FUJIFILM, SCREEN, ISHIHYAKI, KUKUDA, MUSASHI ENGINEERING, mtco. 名義テック株式会社

ブロンズ: Takano CO., LTD., 太陽電機産業

出展者 (NPI) プレゼンテーション (eX-tech) **無料** **事前登録不要** 東3・7ホール セミナー会場

6月10日 (水)		6月11日 (木)		6月12日 (金)	
13:35-13:55	半導体分野を支える熊本の機能性表面処理技術 ㈱オシロテック/ナリサーチ セミナー会場5	11:35-11:55	絶望が“わかる”時代へ：導電性ペーストを進化させるレオ・インピーダンス測定技術 ティー・エイ・インストゥルメント・ジャパン㈱ セミナー会場11	11:35-11:55	チップレット/BGA対応!見えない不良を捜すJTAGテスト最前線 アンダーシステムサポート㈱ セミナー会場10
12:15-12:35	リフロー実装部品の保管環境に対応する信頼性技術の開発 TDK㈱ セミナー会場11	13:35-13:55	電子デバイスの信頼性を支える物性評価：DMAとレオメータの活用事例 ティー・エイ・インストゥルメント・ジャパン㈱ セミナー会場11	12:55-13:15	“なぜ?”を解き明かす材料分析で、製品開発の課題解決へ ㈱カネカテクノリサーチ セミナー会場5
14:55-15:15	半導体分野を支える熊本の機能性表面処理技術 ㈱オシロテック/ナリサーチ セミナー会場4	13:35-13:55	歩留まり向上へ、半導体実装を見える化 ㈱JSOL セミナー会場10	14:15-14:35	フレキシブル性をコアとする低誘電・接着・圧電材料の開発 大阪有機化学工業㈱ セミナー会場10
11:35-11:55	チップレット/BGA対応!見えない不良を捜すJTAGテスト最前線 アンダーシステムサポート㈱ セミナー会場10	14:55-15:15	半導体分野を支える熊本の機能性表面処理技術 ㈱オシロテック/ナリサーチ セミナー会場5		

半導体産業展 専門セミナー **無料** **事前登録不要** 東7ホール セミナー会場12

6月10日 (水)		6月11日 (木)		6月12日 (金)	
11:20-11:50	ばらつきとストレスを前提としたAIサロゲートとロバスト最適化 計測エンジニアリングシステム㈱ ㈱シノコム	半導体・AIが創る未来		6月12日 (金)	
13:00-13:30	正確な故障解析へ!半導体・電子部品向けマイクロ操作技術 ㈱マイクロサポート	「人手不足解消のガキ」特定技能外国人材の採用・定着に向けて ㈱ワールドマーケティングシステムズ		ベトナムの半導体産業における優遇政策 FPTジャパンホールディングス㈱	

E-Textile/Wearable展セミナー **無料** **事前登録不要** 東7ホール セミナー会場主催者企画セミナー E-Textile/Wearable展 (ブース内)

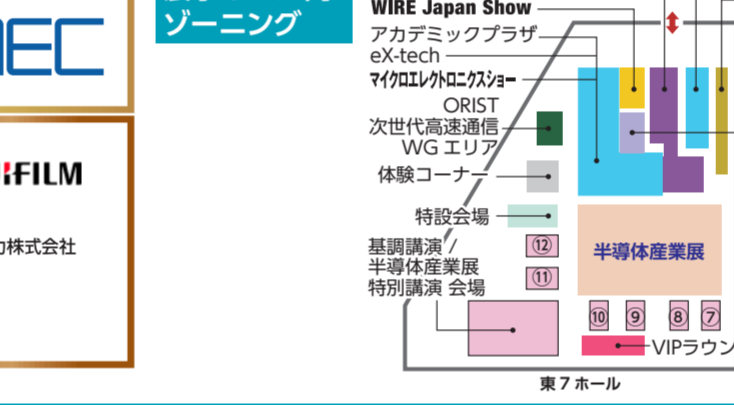
椅子は「デバイス」へ。AIxスマートテキスタイルが導くあなたの「正解姿勢」 中野 浩平 ㈱シノコム イノベーション推進部研究開発セクション	自己修復性・タフネス性を実現したWIZARD Seriesの紹介 ㈱シノコム	竹由來の炭素繊維が切り拓く次世代導電性素材 ㈱シノコム
脳出血からの再起と次世代ウェアラブル：スマートウェア「COVEROSS®」が変えるリハビリ/リカバリーの常識— 鈴木 正秀 ㈱三機システム 代表取締役	「未来の服は、あたたかいだけじゃない。」—発熱・センシング・快適性を融合するスマートテキスタイル技術 松本 正秀 ㈱三機システム 代表取締役	スマートテキスタイル×AIの融合 ㈱ToI Nexus 代表取締役
t-テキスタイル製品化研究会のご紹介 佐藤 孝孝 テキスタイル製品化研究会 地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター 特任技術アドバイザー		

会期中、上記企業・団体によるプレゼンテーションを実施! 詳細はイベントWEBサイトセミナー情報にてご確認ください。

ORIST 次世代高速セミナー **無料** **事前登録不要** 東7ホール セミナー会場主催者企画セミナー ORIST展 (ブース内)

めっきプライマー「メタロイド」の石炭への適用 中澤 悠人 ㈱イオックス 研究開発部	TD-NMR(時間領域NMR)を用いた粉体の濡れ性および高濃度分散体の非破壊評価法の提案 湯田 純子 マツコト・ゾルテック 代表取締役、東北大学大学院工学部 専任准教授	界面が見えないと、なぜ実装は止まるのか?—SFGによる分子レベル評価の手法 花輪 貴也 ANVOS Analytics㈱ 取締役COO
新タック化成膜 受託塗工サービスについて 村井 徹 新タック化成膜 営業本部 上級調査役	高機能樹脂素材のご紹介 長谷川 篤彦 日本化薬㈱ ファインミルズ研究所 第1グループ 担当リーダー	高速通信・半導体パッケージを支える樹脂・フィルム素材 ユニチカ㈱
放熱フィラーとしての酸化亜鉛 西川 由唯 秀化学工業㈱ 研究開発本部	次世代高速通信 VEG エリア 体験コーナー ㈱アンパル・ジャパン、㈱ビジネスユニットキャリアソリューション 総務プロダクト マネージャー	半導体パッケージ基板レーザ加工技術と、フェムト秒レーザー「非加熱加工」応用事例紹介 池本 裕 ㈱オウルテック 新規開発事業部 技術

会期中、上記企業・団体によるプレゼンテーションを実施! 詳細はイベントWEBサイトセミナー情報にてご確認ください。



出展者一覧 2026年4月10日 (金) 現在 (展示会別・50音順・法人格省略)

JPCA Show プリント配線板技術展 国内 愛工機器製作所 アイン 赤羽産業 アスリートFA アドウェルズ アドテックエンジニアリング アドテックジャパン アビステ アポロ技研 アルメックステクノロジー ANVOS Analytics アンパンパル・ジャパン イー・エス・アイ・ジャパン EM ラボ イーマキーナ イオックス EKC アドバンスド・エレクトロニクス3ジャパン 石井表記 石川金属 石原ケミカル イチカワテクノファブリス 稲畑産業 伊原電子工業 インスペック ウシオ電機 エイエルエレクトロロジー エイト工業 エーアイテックロジー エステック NTW Inc FTM テクニカルサービス MI-6 エムアンドシー MSR オーフ製作所 大阪産業技術研究所 (ORIST) 大船企業日本 オカダジーエーエイ 奥野製薬工業 オプトロニクス社 オルガン針 オンテック 華正新材料 キーサイト・テクノロジー キクワエンタープライズ 北川精機 協栄二重エンジニアリング 京亨 京セラ キョウデン クオルク クワボウ ケーシーシャイナースタック ケミトロン 興研 光陽オリエントジャパン 硝化工業 相模ピーシーアイ 佐藤商事 山栄化学 三喜製作所 三見技研工業 SUNBRIDGE	GIS Tech シーエスワイ JSR J-RAS JCU 四国化成工業 進谷工業 ジャプロ工業 松和産業 昭和産業 ショーダテクトロン シライ電子工業 信越化学工業 真企機工 新興電気 新タック化成 SCREEN PE ソリューションズ STAR-J ステラ ステラ・コーポレーション スマート・ソリューション・テクノロジー 住友化学 青電舎 セリアコーポレーション 大成ラミネーター 太陽インキ製造 ダイワ ダイワ工業 高田工業所 高松帝機 タケウチ タツタ電線 田原電機製作所 ちの技研 チューリップ 長興材料工業 角田ブラシ製作所 ティ・エム・ワークス / 鹿ノニック Tebiki デンカ 電気化学システム 電子回路企業年金基金 電路計画 東海神栄電子工業 東京マシニング・アンド・ツール 東明テクノロジー トリア電子 巴工業 ナラサキ産業 日亜化学工業 ニッコン工業 ニッコ・マテリアルズ 日駿 日進化成 ニフコ 日本ゼオン 日本化学産業 日本化薬 日本サーキット 日本材料技研 日本薬工 日本製鋼所 日本電路工業会 (JPCA) 日本バーンズ 伯東 ビダールビー ピアメカニクス 日立ハイテック	平山ファインテクノ ファインテック フィッシャー・インストルメンツ ブイ・テクノロジー フェイス 福田金属造粉工業 フジ精工 不二越 フジブリグループ 富士プリント工業 古川電工業 ブルックスジャパン ベアック ハリテックグローバルマテリアルトレーディング ポルクステクノ マイクロラフ マクセル マザーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン マジエリカ・ジャパン 松尾産業 マックエイト 丸源織工所 ミクロ技術研究所 三菱ガス化学 三菱電機 ムラキ メイコー メイコーテクノ メック (神奈川) メック (兵庫) メトロームジャパン モトロニクス 山勝電子工業 ヤマキ電気 ユアシステム機器 友助 ユニオンツール ユニチカ ユリ電気商会 ヨシミツ理化 ライエレクトロニクス 利昌工業 レイバルド レヨーン工業 ロイコ・ジャパン ローテ・ショルツ・ジャパン 令和マテリアル 海外 Centrum Technology CHEON WESTERN (CHINA) GROUP China Circuit Technology (Shantou) China S.M Materials Dalian Jixing Electronics Eclat Forevar Machinery Elec&Etek (Macao) FSquality Fuji Print industrial (H.K.) Glory Faith (Hongkong) GOL SEARCHERS ZHUHAI GreTech scientific GROUP UP INDUSTRIAL Guangdong Champion Asia Electronics Guangdong Chengde Electronic Technology Han's CNC Science and Technology JIANGSU SUHANG ELECTRONICS Jiangxi Hongyu Precision Manufacturing Jiangxi Jiangnan New Material Technology KASTON	KEY AO MICRO-ELECTRONIC (HONG KONG) Kingboard Laminates Holdings Kingma Printing Machinery KOREA PACKAGING INTEGRATION ASSOCIATION (KPIA) Nanyang Dtech Schmoll maschinen Shandong Shengquan Electronic Materials Shanghai YK Shenzhen Huaren Samwo Technology Shenzhen Jingchengda Circuit technology SHENZHEN NEWCESS INDUSTRIAL Shenzhen SAM Electronic Equipment Shenzhen Technology Trust Precision Industry ShenzhenTIANXI science development SOLDERWELL Songtex Technology Sunus Electronic Technology SYNORM CHEMICAL TAESUNG Taixing Smelting Plant TECHWISE (MACAO) CIRCUITS Trojan (Suzhou) Material Technology United Initiators WECC (世界電子回路業界団体協議会・CPCA, EIPC, ELCINA, GE, HKPCA, IPCA, KPCC, THPCA, TPCA) WEISUN INDUSTRIAL Yiyang jindong Technology Youzhu Industries Zuhai Henger Microelectronic Equipment 3D-MID パビリオン 国内 岩手県工業技術センター I-EX 太陽インキ製造 actnano Inc 日本 MID 協会 半導体パッケージング・部品内蔵技術展 国内 稲畑産業 Wovn Technologies オプトサイエンス クボテック タカノ 東北大学 学際科学プロテクトリア研究所 島津研究室 TOWA TOPPAN 内藤電誠工業 ニコン ニチフ工業 日本電気硝子 ニテックアドバンステクノロジー 日本ミクロン 根上工業 パナソニック インダストリー ピー・アイ・ジャパン フォアサイト 富士フィルム 古河電気工業 マイロク・テック ミカドテクノ 三井金属 モル ロゼッタ 海外 Addison Clear Wave Coating TAKAI Precision Jiangxi Hongyu Precision Manufacturing 国内 AOCジャパン	シーマ電子 タツタ電線 九電工業 山下マテリアル ワールドリンク 海外 Photonics-Systems-Group Taiwan Flex Electronics TSK Wuhan Desytek Environmental Protection & New Materials 機器・半導体受託生産システム展 国内 笠原理化学工業 群馬半導体 スターマイクロ TRIART 富士電子 クオナス DT ソリューションズ 理研電具製造 海外 Global Brands Manufacture Magemell Industry TAI CHYANG ELECTRIC ENG WIN SOURCE ELECTRONICS	FUJI プラズマイオンアシスト ユー・コーポレーション アカデミックプラザ 秋田大学 足利大学 大阪公立大学 大阪公立大学大学院工学研究科 大阪産業技術研究所 岡山大学 工学部 情報・電気・数値データサイエンス系 九州大学 群馬大学 群馬大学大学院 理工学府 甲南大学 信州大学 崇城大学 電磁材料研究所 東京電機大学 東京理科大学 東京理科大学 山本研究室 東北大学 東北大学 遠藤 (鉄)・室賀研究室 東北大学 日暮研究室 富山県立大学 長野工業高等専門学校 高速信号伝送評価センター 長野工業高等専門学校 中山研究室 日本大学 金子研究室 日本大学理工学部精密機械工学科 北海道大学 大学院工学研究科 米澤研究室 山形大学 フレキシブル基盤技術グループ 横浜国立大学	JISSO PROTEC 国内 アポロロボティクス アムエ工業 アルファエレクトロニクス ウイングビジョン エイテックテクトロン エーアイテック エンジニアリング・ラボ SMTジャパン 奥田貿易 奥原電気 化研テック 川崎重工業 共栄興産 弘輝テック コジマプラスチック サーモグラフィクス JNC 石油化学 JIFE 商事エレクトロニクス ジック Shimada Appli 新菱 大洋工作所 TDK ティー・エイ・インストゥルメント・ジャパン TEGソリューションズ テクノトロン・サプライ CHEMIFAZ 江東電気 コジマプラスチック サーモグラフィクス JNC 石油化学 JSOL Shimada Appli 新菱 大洋工作所 TDK ティー・エイ・インストゥルメント・ジャパン TEGソリューションズ テクノトロン・サプライ 電気印刷研究所 電子技研 東洋紡 長瀬産業 日本高熱処理化学 ノードン パナック 日本トムソン	日本スベリア社 ニホンハンダ 日本ミルテック 日本ロボット工業会 (JARA) パーミジャパン パスコ パナソニック パナソニック コネクト FUJII マルコム 丸文 武蔵エンジニアリング 名菱デクニカ ヤマハ発動機 ユーテックロジー ユニテック グリス電子 PEMTRON SET ユシロ ヨコオ レファ 半導体産業展 アスカインテックス アポロ イノコム EIZO イーディーエステック 最先端デジタル SoC 設計人材育成プログラム (ADIP) FFT ジャパンホールディングス MCC エルテック 川瀬産業 河本化成工業 QMS クボラフ クリエティブテクノロジー 計測エンジニアリングシステム ケーマックステクノロジー 神津精機 サカセ化学工業 坂本電機製作所 産業タイムズ社 santec Japan シンコム 清和光学製作所 第五電子工業 高井電機 テクノハンズ デロイトトーマツ 東京ダイヤモンド工具製作所 東洋精密工業 徳力本店 日進工具 ネグロス電工 フィールドマーケティングシステムズ フォームファクター 物質・材料研究機構 ペトルジャパン マイクロサポート 松田産業 山勝商会 ヨクスル 洛陽化成 リオン リンテック ロキテクノ アオイ電子 エムテックスマツラ 加藤電機製作所 協栄プリント技研 コスミック シマダ益田電子 新光電気工業 デンケン 日本 OSAT 連合会 日本ナショナルインストゥルメンツ ハマダテクノス ファオードテクノロジ ブイ・テクノロジー 菱達テック AccoTEST Japan Yuiobot Robotics Japan
---	---	---	--	--	---	--	--

※本招待状に掲載のプログラム他は、変更となる場合がございます。予めご了承ください。講演当日は早めの受付にて協力をお願いいたします。